香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION

合肥晶合集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2249)

須予披露及關連交易進展公告
訂立增資協議

茲提述合肥晶合集成電路股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年11月5日的公告(「**該公告**」)，內容有關本公司擬與目標公司、合肥建投及合肥勤合訂立增資協議，據此，本公司、合肥建投及合肥勤合將合計以現金人民幣9,100百萬元認購目標公司新增註冊資本(「**本次增資**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於2026年11月19日，本公司、目標公司、合肥建投及合肥勤合已簽署增資協議。增資協議的主要條款及本次增資的詳情請參閱該公告。

根據增資協議的約定，增資協議自各方法定代表人或授權代表簽字或簽章並加蓋公章後成立，並於本公司股東會審議通過本次增資後生效。因此，增資協議及其項下擬進行的本次增資仍須於本公司將召開的臨時股東會上取得獨立股東批准。

誠如該公告所披露，一份載有(其中包括)增資協議及其項下擬進行的本次增資的進一步詳情、獨立董事委員會函件、獨立財務顧問意見函件及臨時股東會通告的通函，預期將於2026年12月31日或之前刊發並寄發予股東。本公司將根據上市規則的適用規定，適時就本次增資的後續進展刊發進一步公告。

承董事會命
Nexchip Semiconductor Corporation
合肥晶合集成電路股份有限公司
執行董事兼董事長
蔡國智先生

香港，2026年11月19日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、邱文生先生、郭兆志先生及楊國慶女士；及(iii)獨立非執行董事盛明泉教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。